

TECHNISCHE DETAILS – MetalClad / IMS – Standard

Parameter	Technische Angaben	Bemerkung
Basismaterial	Aluminium, Kupfer, Stahl	unterschiedliche Dicken je nach Anforderung
Dielektrikum	75 - 300 µm	wählbar nach Wärmeleitfähigkeit
Leiterplattendicke	0,3 mm – 4,0 mm	
Kupfer	35 -210 µm	
Max. Leiterplattenabmessung	600 mm x 1500 mm	
Min. Bohrdurchmesser	0,20 mm	Durchmesser >6 mm werden gefräst.
Leiterbahnbreiten/Abstände	150 µm / 150 µm	
Thermische Leitfähigkeit	1,0 - 400 W/mK	entsprechend Dielektrikum und Aufbau
Thermischer Widerstand	0,052 - 0,086 °C/W	TO-220 Test
Durchschlagsfestigkeit	30kV/mm	IPC-TM-650 2.5.7
Maximale Betriebstemperatur	125°C	UL-746
Tg	130°C	DSC-Test
Dielektrizitätskonstante (1MHz)	5,4	ASTM D150
Lötbeständigkeit	288 °C, 30 sek.	UL
Brennbarkeit	V-0	UL-94
Kundenspezifische Anforderungen	Auf Anfrage	

Stand: Dezember 2015